

RoHS2.0 物质声明书

RoHS2.0 Product Material Declaration

杭州士兰微电子股份有限公司承诺提供的产品，符合欧盟 RoHS2.0 指令、包装指令、欧盟 WEEE 指令和欧盟 REACH 法规等，并符合以下化学物质禁用/限用标准：

Hangzhou Silan Microelectronics CO.,LTD. guarantees that the deliverable products, Conform to EU RoHS 2.0 directive, packing directive, EU WEEE directive and REACH directive, meeting SOC of:

物质名称 Substance name	禁用标准 Standard
镉以及镉化合物 (Cd)	<5 ppm
铅以及铅化合物 (Pb)	<100 ppm
汞以及汞化合物 (Hg)	N. D. <2 ppm
六价铬化合物 (Cr ⁶⁺)	N. D. <2 ppm
聚溴联苯 (PBBs)	N. D. <5 ppm
聚溴二苯醚 (PBDEs)	N. D. <5 ppm
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	<1000ppm
邻苯二甲酸(2-乙基己基酯) (DEHP)	<1000ppm
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	<1000ppm
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	<1000ppm
包装材料(镉+铅+汞+六价铬总和 Pb+Cd+Hg+Cr ⁶⁺)	<100ppm (Cd<5ppm)

备注：Silan 中大功率封装器件产品使用铅锡银高温焊料，符合欧盟 RoHS2.0 指令 (2015/863) 豁免第 7 (a) 项规定的含铅量大于 85% 的高温焊料豁免应用，符合 RoHS2.0 标准。

杭州士兰微电子股份有限公司
质量管理中心

2024-5-17

质量管理中心

